

中国电子商情 **基础电子**

www.ChinaEM.com.cn

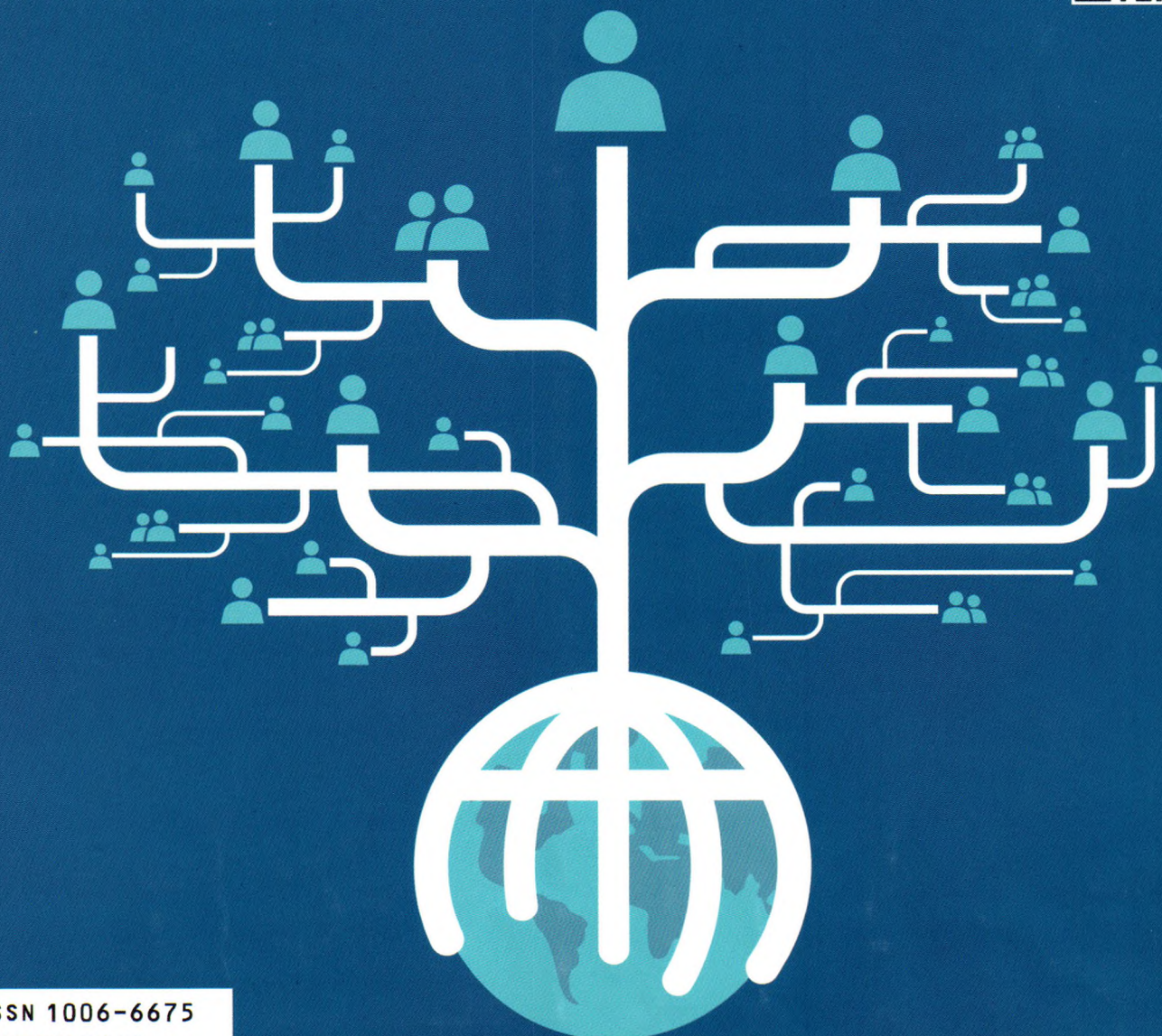


2017年6月 总第1040期

专题报道

从数据通信角度看万物互联

P29



ISSN 1006-6675



P32 25G ToR交换机规范细节公布，加快25G红利期到来
P35 具有数据传输能力的3.5mm插孔和USB-C争抢耳机应用

8

产业聚焦

数字财富

- 10 ADI MEMS研发进入高产模式，工业物联网是主要应用市场
- 13 Microchip领行业之先，MCU集成GPU和DRAM 实现图形功能新突破
- 15 中国功率集成电路制造产业前景广阔

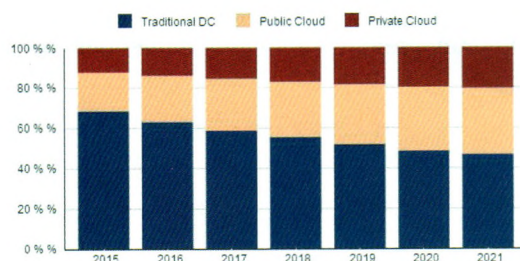
16

技术前沿

一款毫米波传感器，TI为业界带来诸多惊喜

德州仪器 (TI) 针对汽车和工业应用，最新推出的包含5个解决方案的全新单芯片76至81GHz毫米波传感器，两大产品系列AWR1x和WR1x传感器产品组合不仅提供比目前市场上毫米波解决方案高3倍的感测精度，CMOS技术的使用，使得芯片的功耗和电路板面积减少50%。

- 18 Qorvo让RF无处不在
- 20 Cadence Tensilica Vision C5 DSP完美匹配嵌入式神经网络需求
- 22 矩阵式LED调光器准确控制RGBW LED组的色彩并产生准确图案
- 25 全高级驾驶员感知系统和AI Programmable SoC



- 2017年公有云基础设施支出超过私有云

根据IDC全球季度云计算IT基础架构的最新预测，IT基础架构产品（服务器、企业存储和以太网交换机）的总支出用于部署在云环境中的支出，2017年将同比增长15.3%至417亿美元。公有云数据中心占这一支出的大部分，占60.5%，而私有云环境将占支出的14.9%。本地私有云将占私有云IT基础设施支出的62.3%，并将在2017年同比增长13.1%。

29

专题报道

从数据通信角度看万物互联

过去十年间，日新月异的数据通讯技术不断打破地球上速度的极限和空间的约束。如今，我们可以通过微信实时为大洋彼岸的朋友送去一段视频祝福，也可以直播在海南三亚的浪漫婚礼。在这个万物互联的时代，数据通讯技术的突飞猛进，特别是用于存储、处理、传输数据的数据中心，其迅猛发展、不断迭代，也在不断重新定义人们生活方式。

- 32 25G ToR交换机规范细节公布，加快25G红利期到来
- 35 具有数据传输能力的3.5mm插孔和USB-C争抢耳机应用

39 制造与测试

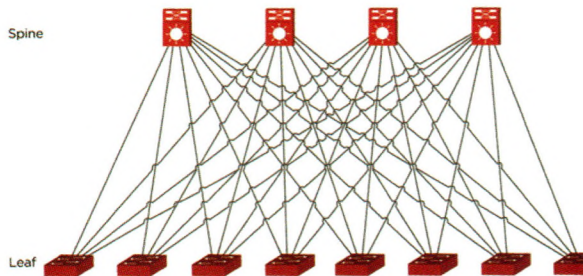
32Gbps高速SerDes量产测试方案

SerDes测试主要分BIST测试和high speed I/O测试。BIST测试主要依赖于芯片内部的测试模块，测试芯片功能是否正常，其主要特点是测试效率高，成本低，对load board等硬件制作要求低，但无法测试芯片的特性，测试覆盖率相对较低，并且无法失效定位。而High speed I/O测试基本可以满足所有SerDes测试需求，测试覆盖率高。

43 工程师博客

微博览

相比于无人驾驶汽车，车联网是用以解决大众交通问题的出路，当然车联网面临的技术问题和社会问题比单一的无人驾驶汽车要复杂得多，涉及信息采集、传递、计算、反馈、控制等方方面面的技术，特别关键的是，需要5G网络的高速传输需求，但这是未来交通的必经之路。



● 25G ToR交换机规范细节公布，加快25G红利期到来

ODCC的25G TOR规范是以百度和阿里为代表的中国互联网企业数据中心网络需求的体现，25G产业界比较早的明确提出了对25G TOR的硬件规格需求，也为相关OEM/ODM供应商指明了产品研发路标。随着25G网络部署的进展，该技术规范也可能根据业务需求进一步细化或调整。预计中国首批25G网络规模部署的开始时间为2017年上半年，更大规模的部署预计将发生在2018年。提供大规模IaaS云服务的企业预计会更加积极的部署25G网络。

46 资讯快报



China
Electronics
Fair

Since 1964

中国电子展·西部

2017中国(成都)电子展

推进智能制造 促进军民融合

成都世纪城新国际会展中心 · 2017年7月13-15日

九大展区全面展示行业热点

智能制造展区：3D 打印、无人机、智能机器人、SMT 技术和设备、线束设备、激光设备、PCB 及 PCB 制造设备、半导体及半导体制造设备等

军民融合展区：军用电子元器件、指挥控制装备、电子对抗系统、仿真系统、军事物联网等

电子元器件展区：被动元件、元器件分销、半导体分立器件、连接器、集成电路等

测试测量展区：电子和通信仪器、电工仪器仪表、环境试验仪器和设备、微波射频和 EMC 测试、分析仪器、认证检测、自动化仪器仪表等

微波射频与电磁兼容展区：微波元器件、通信整机、微波材料、微波射频检测仪器、专用软件；电磁测量仪表与设备、EMI 屏蔽材料、屏蔽室、防雷 / 滤波技术、解决方案、标准与认证等

物联网展区：智能家居、远程医疗、云端医疗、移动医疗 APP、智慧城市

智能硬件展区：智能手机、平板电脑、智能手表、可穿戴电子、智能汽车相关产品、LED 智能照明等

创新创业展区：智能硬件解决方案、移动互联网应用等

大数据展区：大数据与健康医疗、大数据与金融创新、大数据与电子商务、大数据与智慧城市、大数据与地理空间信息、大数据与智能制造等

支持单位： 成都市人民政府
四川省经济和信息化委员会
四川省国防科学技术工业办公室
中国电子信息产业集团有限公司

主办单位： 中国电子器材总公司

承办单位： 中电会展与信息传播有限公司

协办单位： 成都市经济和信息化委员会
成都市博览局

联系方式：

电话：北京：010-51662329
成都：028-85910836/84477973
上海：021-39254818/28

传真：北京：010-53216092
成都：028-84477973
上海：021-39254828

邮箱：914341271@qq.com



官方微信

www.icef.com.cn
万方数据